公司代码:688216　　公司简称:气派科技

# 气派科技股份有限公司

## 【2025】年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司可能面临的各种风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分,请投资者注意投资风险。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

鉴于公司2025年亏损,公司拟不进行现金分红,也不送红股、不进行资本公积金转增股本。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 气派科技 | 688216 | 不适用 |

1.2公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 文正国 | 王绍乾 |
| 联系地址 | 广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦 | 广东省东莞市石排镇气派科技路气派大厦 |
| 电话 | 0769-89886666 | 0769-89886015 |
| 传真 | 0769-89886013 | 0769-89886013 |
| 电子信箱 | IR@chippacking.com | IR@chippacking.com |

2、报告期公司主要业务简介

2.1主要业务、主要产品或服务情况

1、公司的主营业务

公司主要业务为半导体封装和测试业务,主要分为三部分:集成电路封装测试业务、功率器件封装测试业务、晶圆测试业务,公司始终专注于向客户提供更有竞争力的封装测试产品,通过持续不断的研发投入,凭借自身对已成熟封装形式的深入理解,秉持创新精神对封装形式进行再解析,充分满足客户对产品的需求。

半导体封装测试包括封装和测试两个环节,因测试业务主要集中在封装企业中,通常统称为封装测试业。

(1)封装是指对通过测试的晶圆进行背面减薄、划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋成型等一系列加工工序而得到独立的具有完整功能的集成电路的过程。封装的目的是保护芯片免受物理、化学等环境因素造成的损伤,增强芯片的散热性能,以及便于将芯片端口联接到部件级(系统级)的印制电路板(PCB)、玻璃基板等,以实现电气连接,确保电路正常工作。

(2)测试主要是对晶圆、芯片或集成模块的功能、性能等进行测试,通过测量、对比输出响应和预期输出,以确定或评估半导体元器件的功能和性能,其目的是将有结构缺陷以及功能、性能不符合要求的产品筛选出来,是验证设计、监控生产、保证质量、分析失效以及指导应用的重要手段。

2、公司的主要产品

公司所处行业属于半导体三大产业链之一的封装测试业,封装测试行业的创新主要体现为产品工艺上的创新,技术水平主要体现为产品加工的工艺水平,公司在芯片封装测试行业深耕十多年,通过对生产技术和工艺的创新,逐渐形成了具有自主特色的封装产品,形成了自身的核心竞争优势。公司集成电路封装主要产品有MEMS、FC、5G氮化镓射频器件塑封封装、LQFP、QFN/DFN、CQFN/CDFN、CPC、SOP、SOT、OIPAI、DIP等多个系列产品共计超过300种封装形式,产品主要运用于消费电子、信息通讯、智能家居、物联网、工业自动化控制、汽车电子等多个领域;功率器件封装主要产品为紧凑型表面贴装器件封装(PDFN/PQFN)、晶体管封装(TO)、功率模块封装(IPM)、铜夹焊封装(LFPAK)等。除此以外,公司还为客户提供晶圆测试服务。

2.2主要经营模式

1、业务模式

公司从事半导体封装测试一站式服务,主要业务分为集成电路封装测试、功率器件封装测试、晶圆测试。

①集成电路封装测试业务

客户向公司提供晶圆,公司采购引线框架、丝材、装片胶和塑封树脂等原辅料,按照客户要求对其提供的晶圆芯片通过晶圆背部减薄研磨、晶圆切割、装片/固晶、键合/焊线、塑封、电镀、打标、切筋(切割)、测试、外观检测、包装等一系列加工工序加工出合格的芯片成品等进行一系列内部工艺加工以及外协辅助加工,公司完成芯片封装测试的精密加工后将成品交还给客户,向客户收取封装测试加工费,获取收入和利润。

此外,在了解客户需求的基础上,公司会自行采购一些通用芯片的晶圆,在公司封装测试产能允许的条件下进行封装测试形成芯片成品,在客户有需求时将这些芯片成品销售给客户,从而平衡公司产能、以及取得收入和获取利润。

客供芯片封装测试由客户提供晶圆芯片,自购芯片封装测试由公司自行采购晶圆芯片;除此以外,公司的客供芯片封装测试和自购芯片封装测试的采购模式、生产模式、销售模式、研发模式没有差别。

②功率器件封装测试业务

功率器件封装测试业务的业务模式与集成电路封装测试业务一致,由客户向公司提供晶圆,公司通过晶圆切割、装片/焊芯片、键合/压焊/铜夹焊/回流焊、塑封、电镀、打标、切割、测试、外观检测、包装等加工工序加工出合格的功率器件成品,公司将功率器件成品归还给客户,向客户收取封装测试加工费。

③晶圆测试业务

客户向公司提供晶圆,由客户提供或由公司自行开发测试程序,通过芯片测试设备和探针台对晶圆上的每一颗芯片的电气特性进行检测,将不合格的芯片标记出来,在后续的封装过程中,不合格的芯片将被淘汰,不再进行封装,避免增加封装和成品测试的成本。公司将晶圆测试完毕后交还给客户或转交给封装测试工序进行下一步加工,公司向客户收取晶圆测试服务费。

2、采购模式

公司设置采购部、计划部等部门,根据公司生产需要,针对集成电路封装测试加工所需的原材料、辅料、备件、包材等物料进行采购,除此之外,公司还对生产设备、外协加工服务项目进行采购。

3、生产模式

公司作为专业封装测试厂商,致力于为客户提供多样化、针对性、差异化及个性化的封装测试产品与服务,同时通过对生产系统的管理,对生产产品的品种和产量能够快速灵活的调整,形成了以多样化定制生产、快速切换为主的柔性化生产模式。

4、销售模式

公司销售环节采用直销模式,公司客户主要为芯片设计公司。绝大部分芯片设计公司由于本身无晶圆制造环节和封装测试环节,其自身只根据市场需求设计集成电路版图。该等芯片设计公司完成芯片设计后,将其交给晶圆代工厂制造晶圆,晶圆完工后交给公司,由公司对晶圆进行封装测试,之后芯片设计公司将公司封装测试后的集成电路销售给电子整机产品制造商,最后由电子整机产品制造商以电子整机的形式销售给终端消费者。

5、研发模式

公司主要采用自主研发模式,公司设有研发中心,全资子公司广东气派设有技术工程研究中心,主导新技术、新产品的研究和开发。根据公司的发展战略和发展目标、承接政府部门的攻关项目、销售部门市场调研、客户定制等确定研发项目,经内部立项、设计和开发、反馈和纠正、产品试制、小批量试生产等阶段完成研发工作。公司也通过产学研、企业间合作等方式进行合作研发模式。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1)所处行业

公司主营业务为半导体封装和测试业务,根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2017),公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)下属的集成电路制造业(C3973),具体细分行业为集成电路封装测试业,根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类(2018)》分类,公司属于新一代信息技术产业中的集成电路制造。

(2)行业发展阶段及基本特点

集成电路是20世纪50年代发展起来的一种半导体微型器件,是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等特定加工工艺,按照一定的电路互联,把晶体管、电阻、电容、电感等电子元器件及连接导线,全部集成在微型硅片上,构成具有一定功能的电路,然后封装成电子微型器件,成为能执行特定电路或系统功能的微型结构。

集成电路封装测试包括封装和测试两个环节,因测试业务主要集中在封装企业中,通常统称为封装测试业。封装是指对通过测试的晶圆进行背面减薄、划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋成型等一系列加工工序而得到独立的具有完整功能的集成电路的过程。封装的目的是保护芯片免受物理、化学等环境因素造成的损伤,增强芯片的散热性能,以及便于将芯片端口联接到部件级(系统级)的印制电路板(PCB)、玻璃基板等,以实现电气连接,确保电路正常工作。测试主要是对芯片或集成模块的功能、性能等进行测试,通过测量、对比集成电路的输出响应和预期输出,以确定或评估集成电路元器件的功能和性能,其目的是将有结构缺陷以及功能、性能不符合要求的产品筛选出来,是验证设计、监控生产、保证质量、分析失效以及指导应用的重要手段。

集成电路产业诞生于美国,并迅速在欧洲、日本、韩国等地发展起来,但是随着产业的技术进步和市场发展,封装测试环节的产能已逐渐由美、欧、日等地区转移到中国台湾、中国大陆、新加坡、马来西亚和菲律宾等亚洲新兴市场区域。中国台湾地区是最早兴起集成电路专业封装测试代工模式的地区,也是目前全球最大的集成电路封装测试基地,中国大陆位居其次。

集成电路封测属于IC产业链偏下游的行业,通常封装和测试都是一体的,即做完封装后直接进行产品的测试。IDM和OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly&Test,半导体封装测试代工模式)是半导体封测产业的两种主要模式。伴随着半导体行业垂直分工趋势,OSAT模式将成为封测行业的主导模式。

封装的发展史也是芯片性能不断提高、系统不断小型化的历史。随着集成电路器件尺寸的缩小和运行速度的提高,对集成电路也提出新的更高要求。封装历史发展大概分为五阶段,第一阶段为通孔插装型封装(TO、DIP),第二阶段为表面贴装型封装(OFP、QFN、DFN、SOP、SOT),第三阶段为球栅阵列封装(BGA)、晶圆级(WLP)和芯片级封装(CSP),第四阶段为多芯片组封装(MCM)、系统级封装(SIP)、三维立体封装(3D)、bumping,第五阶段为微电子机械系统封装(MEMS)、晶圆级系统封装-硅通孔(TSV)、倒装焊封装(FC)、表面活化室温连接(SAB)、扇出型集成电路封装(Fan-Out)、扇入型集成电路封装(Fan-in)。全球封装行业的主流技术处于以CSP、BGA为主的第三阶段,并向以系统级封装(SiP)、倒装焊封装(FC)、芯片上制作凸点(Bumping)为代表的第四阶段和第五阶段封装技术迈进。

集成电路下游应用广泛,涵盖消费电子、电力电子、交通、医疗、通讯技术、航空航天等众多领域。近年来,随着物联网、人工智能、云计算、大数据、5G、机器人等新兴应用领域的蓬勃发展,各类集成电路产品的使用场景和用量不断增长,为集成电路产业注入了新的增长动力。

从应用端来看,随着新能源汽车、人工智能、大数据、5G的快速发展,集成电路未来的需求将越来越大,集成电路的规模将持续增长。从国产替代来看,我国集成电路贸易逆差逐年增大,国产替代是未来几年的主旋律,因此,集成电路产业一直被视为国家层面的战略新兴产业,国家发展战略、行业发展规划、地方发展政策不断出台,为集成电路行业提供了财政、税收、投融资、知识产权、技术和人才等多方面的支持,推动集成电路行业的技术突破和整体提升,随之也推动了封装测试产业的快速发展。

集成电路封装测试行业的特点主要有:一是,技术密集,集成电路封装测试行业属于技术密集型产业,涉及到材料科学、电子工程、机械工程等多个学科领域的知识和技术。随着封装测试技术的不断发展,对专业人才的需求也越来越高。二是,高精度要求,集成电路封装测试过程中,对精度的要求非常高。因为封装测试直接影响到产品的性能和可靠性,所以必须使用高精度的封装和测试设备,以确保产品质量。三是,高度自动化,为了提高生产效率和产品质量,集成电路封装测试行业广泛采用自动化设备和系统。这些设备和系统可以自动完成封装、测试、分选等多个环节,提高生产效率和产品质量稳定性。四是,质量控制严格,集成电路封装测试行业对产品质量控制非常严格。因为集成电路产品广泛应用于计算机、通信、消费电子等领域,如果产品质量不过关,将会直接影响到用户的使用体验和企业的声誉。因此,封装测试企业通常会建立完善的质量管理体系,对产品质量进行全面控制。五是,竞争激烈,集成电路封装测试行业竞争激烈,市场上存在众多企业。为了在竞争中脱颖而出,企业需要不断提高技术水平、优化生产流程、降低成本、提高产品质量等方面做出努力。

(3)主要技术门槛

集成电路封装测试行业属于资金密集型、技术密集型行业,封装技术对于芯片来说是必须的,也是至关重要的。一方面,芯片必须通过封装才能与外界隔离,以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。另一方面,封装后的芯片也更便于安装和运输。封装工艺的功能包括功率分配(电源分配)、信号分配、散热通道、隔离保护和机械支持等,每一项功能都能影响芯片的性能,封装技术的好坏还直接影响到芯片自身性能的发挥和与之连接的PCB(印制电路板)的设计和制造。因此,封装结构的设计难度、高度精密化的加工工艺是行业的主要技术门槛。

封装技术是集成电路封装测试行业的基础,涉及到芯片与封装材料的连接、封装结构的设计、封装工艺的控制等方面。这些技术需要企业具备专业的研发团队和先进的封装设备,以确保产品的质量和可靠性。测试技术是集成电路封装测试行业的核心技术之一,需要对集成电路进行全面、准确的测试,以确保产品的性能和可靠性。测试技术需要企业具备先进的测试设备和测试方法,同时需要专业的测试工程师进行测试方案的设计和实施。随着集成电路封装测试行业的发展,自动化技术的应用越来越广泛。企业需要掌握先进的自动化技术,包括自动化测试设备、自动化生产线等,以提高生产效率和产品质量稳定性。此外,集成电路封装测试行业对质量控制要求非常高,需要建立完善的质量管理体系,对产品质量进行全面控制。企业需要掌握先进的质量控制技术,包括统计过程控制、可靠性分析等,以确保产品质量符合标准。因此,封测企业需要不断提高技术水平、优化生产流程、降低成本、提高产品质量等方面做出努力,以在竞争激烈的市场中保持有力的竞争力。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司成立于2006年,经过多年的沉淀和积累,公司已发展成为华南地区规模最大的内资半导体封装测试企业之一,是我国内资半导体封装测试服务商中少数具备较强的质量管理体系、工艺创新能力的技术应用型企业之一。

公司自成立以来始终坚持以自主创新驱动发展,注重半导体封装测试技术的研发升级,通过产品迭代更新构筑市场竞争优势。公司掌握了5G基站GaN微波射频功放塑封封装技术、高密度大矩阵集成电路封装技术、小型化有引脚自主设计的封装方案、封装结构定制化设计技术、FC封装技术、MEMS封装技术、大功率碳化硅芯片塑封封装技术、基于铜夹互联的大功率硅芯片封装技术等多项核心技术,形成了自身在半导体封装测试领域的竞争优势,在半导体封装测试领域具有较强的竞争实力。

公司全资子公司广东气派于2017年9月通过广东省科学技术厅“广东省气派集成电路封装测试工程技术研究中心”认定。2019年12月,公司自主定义的“CPC封装技术产品”被广东省高新技术企业协会认定为“广东省高新技术产品”。2020年4月,广东气派通过东莞市科学技术局“东莞市集成电路封装测试工程技术研究中心”认定。2020年8月,中国半导体行业协会等将公司“CPC封装技术产品”评选为“中国半导体创新产品和技术”。2020年12月,广东气派被国家工信部评为第二批专精特新“小巨人”企业。广东气派拥有“2021年市重点实验室——东莞市第三代半导体封装测试重点市实验室”。2021年3月,公司“5G基站用氮化镓(GaN)分立式射频器件”被广东省高新技术企业协会评选为“2020年广东省名优高新技术产品”。2022年5月,公司被广东省工业和信息化厅评为“广东省省级企业技术中心”。2022年,广东气派被评为2021年东莞市智能制造示范项目。2022年,广东气派被东莞市工业和信息化局认定为智能工厂。2022年,广东气派被东莞市科学技术局认定为“2021年东莞市百强创新型企业”。2022年,广东气派被评为广东省知识产权示范企业。 2023年,公司精益生产管理和质量精准追溯2个场景上榜国家智能制造优秀场景。2024年,公司5G 基站GaN射频功放塑封封装技术通过2024年广东省省级制造业单项冠军。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期,半导体封装测试行业在AI算力需求爆发与国产替代加速的双重引擎驱动下迎来温和式复苏,随着科技的不断进步和市场需求的日益增长,半导体封装测试技术的发展成为了推动整个产业向前迈进的关键因素。

在新技术方面,高密度封装技术是当前半导体封装领域的一大热点。随着摩尔定律的推进受限,提高芯片集成度成为提升性能的关键手段。2.5D/3D封装(以CoWoS技术为核心)在AI芯片领域规模化应用,市场规模显著增加;Chiplet异构集成技术应用在头部封测企业得到充分的应用;FOWLP(扇出型晶圆级封装)在移动终端支撑5G射频芯片量产。

展望未来,行业将加速迈向高质量发展新阶段,先进封装规模将持续提升,Yole预测先进封装市场规模将从2024年的450亿美元增长至2030年的800亿美元,年复合增长率达9.4%;传统封装虽增速缓慢,但市场规模仍大;AI芯片、汽车电子、量子计算三大新兴应用驱动封测业持续增长;国产替代深化、产业链整合加速、绿色低碳转型的三重浪潮下,行业正从“技术跟随者”全面转向“生态引领者”。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2025年 | 2024年 | 本年比上年增减(%) | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 2,011,455,813.29 | 1,999,716,609.09 | 0.59 | 1,865,430,086.08 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 582,060,760.75 | 653,632,645.47 | -10.95 | 745,300,254.67 |
| 营业收入 | 768,788,576.63 | 666,562,484.81 | 15.34 | 554,296,295.91 |
| 利润总额 | -82,263,200.85 | -105,458,829.05 | 不适用 | -160,151,055.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -75,384,030.44 | -102,113,713.12 | 不适用 | -130,966,944.18 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -86,577,155.56 | -121,123,621.80 | 不适用 | -153,617,170.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,544,650.27 | -29,549,251.68 | 不适用 | 37,192,636.71 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -12.20 | -14.59 | 不适用 | -16.06 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.71 | -0.96 | 不适用 | -1.24 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.71 | -0.96 | 不适用 | -1.24 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 6.73 | 7.59 | 减少0.86个百分点 | 8.47 |

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 131,615,560.56 | 194,290,922.21 | 204,643,045.36 | 238,239,048.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -32,172,383.38 | -26,496,251.17 | -18,000,155.62 | 1,284,759.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -36,320,451.45 | -29,749,898.48 | -22,303,865.74 | 1,797,060.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,864,843.71 | 33,972,166.29 | 5,881,591.79 | 43,555,735.90 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 6,810 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 7,166 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 梁大钟 | -5,360,000 | 45,790,000 | 42.84 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 白瑛 | 0 | 10,800,000 | 10.10 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 信达证券-平安银行-信达证券聚合2号集合资产管理计划 | 5,343,900 | 5,343,900 | 5.00 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 梁淑娟 | 1,222,319 | 1,222,319 | 1.14 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 施保球 | 0 | 1,079,800 | 1.01 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 童晓红 | 0 | 941,359 | 0.88 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 气派科技股份有限公司-2023年员工持股计划 | 103,420 | 868,818 | 0.81 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 虞玉明 | 0 | 845,194 | 0.79 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 190,502 | 737,312 | 0.69 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 林新 | 657,824 | 657,824 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、上述前十名股东持股情况中,公司实际控制人梁大钟和白瑛是夫妇关系,合计持有公司52.86%股份;白瑛女士持有气派科技股份有限公司-2023年员工持股计划2.02%的份额;<br>2、除以上股东存在的关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

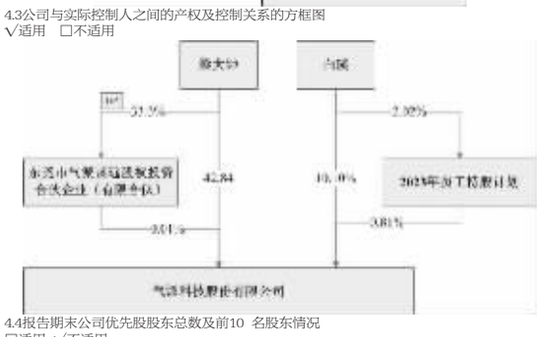
□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用




4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,营业收入76,878.86万元,较上年同期增加10,222.61万元,增长幅度为15.34%,归属于上市公司股东的净利润-7,538.40万元,较上年同期亏损减少2,672.97万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,657.72万元,较上年同期亏损减少3,454.64万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:688216　证券简称:气派科技　公告编号:2026-021

# 气派科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

气派科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月31日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定,为满足公司未来发展需要,公司董事会拟提请股东会授权董事会办理向特定对象发行股票,融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%,授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司股东会审议通过。具体情况如下:

一、本次授权具体内容

本次提请股东会授权事宜包括但不限于以下内容:

(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(二)发行证券的种类、数量、面值

本次发行股票的种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定,不超过本次发行前公司总股本的30%。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行数量上限将进行相应调整。最终发行数量以中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的数量为准。

(三)发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过三十五名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,若国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有新的规定,公司将按新规定进行调整。本次发行的发行对象均以现金方式认购。

(四)定价基准日、定价原则、发行价格

本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)。

如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行价格将进行相应调整。

最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法规的规定和监管部门的要求,由董事会根据股东会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定,根据本次发行申购报价情况,按照价格优先等原则确定,但不低于前述发行底价。

(五)本次发行的限售期

本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

本次发行结束后,由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

(六)募集资金用途

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金用途应当符合下列规定:

1、应当投资于科技创新领域的业务;

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

3、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

4、资金项目实施后,不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性。

(七)发行前的滚存利润安排

本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

(八)上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市。

(九)本次发行决议有效期

自公司2025年年度股东会审议通过之日起,至公司2026年年度股东会召开之日止。

(十)授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在相关法律、法规、规范性文件的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项,包括但不限于:

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,对本次发行方案进行适当调整、补充,确定本次发行的最终具体方案并办理发行方案的具体实施,包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况,对募集资金投资项目及其具体安排进行调整;

3、办理本次发行申报事宜,包括但不限于根据监管部门的要求,制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的申报文件及其他法律文件,回复相关监管部门的反馈意见,并按照监管要求处理与本次发行相关的信息披露事宜;

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议,包括但不限于股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件;

5、设立本次发行的募集资金专项账户,办理募集资金使用的相关事宜;

6、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况,办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记或备案;

7、本次发行完成后,办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜;

8、如与本次发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求,根据新的规定和要求,对本次发行的具体方案作相应调整;

9、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构,并处理与此相关的其他事宜;

10、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施,或者虽然可以实施,但会给公司带来不利后果的情形下,酌情决定本次发行方案进行调整、延期实施或提前终止并撤销发行申请;

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内办理与本次发行 相关的其他事宜。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年3月31日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意公司自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票。

四、风险提示

本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,议案所述本次授权事项尚待公司2024年年度股东会审议通过。

经年度股东会授权上述事项后,董事会将根据实际情况决定是否在授权时 限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易程序向特定对象发行股 票过程中,董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海 证券交易所审核并需经中国证监会注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:688216　证券简称:气派科技　公告编号:2026-012

# 气派科技股份有限公司2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●气派科技股份有限公司(以下简称“气派科技”“公司”)拟定2025年度利润分配方案为:不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

●本年度不进行现金分红,主要原因为2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为负,不符合《气派科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)现金分红条件的相关规定。

●公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板股票上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具“天职业字[2026] 10460号”审计报告,气派科技2025年度实现归属公司股东的净利润-75,384,030.44元,截至2025年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币-56,658,020.57元,母公司累计未分配利润为69,642,598.21元。经董事会决议,公司2025年度拟不进行现金分红,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定,公司2025年度实现的归属于母公司股东的净利润为负,属于可不进行利润分配的情形。综合考虑公司盈利状况、发展战略、发展规划及资金需求,为保障公司持续、稳定、健康发展,经公司审慎研究讨论,拟定2025年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

二、公司履行的决策程序

2026年3月31日(星期二),公司召开了第五届董事会第五次会议,经全体董事审议,以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》,董事会同意本次利润分配预案并同意提交2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素,且方案尚需提交2025年年度股东会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2026年4月2日

证券代码:688216　证券简称:气派科技　公告编号:2026-018

# 气派科技股份有限公司关于2023年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期届满暨解锁条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

气派科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月31日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于2023年员工持股计划首次受让部分第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》,公司2023年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)首次受让部分第二个锁定期已于2026年3月17日届满且解锁条件已成就。现将有关事项说明如下:

一、本员工持股计划的实施进展

(一)公司于2023年10月31日召开的第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十次会议,于2023年11月16日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司(2023年员工持股计划(草案))及其摘要的议案》,同意公司实施2023年员工持股计划。具体内容详见公司于2023年11月1日、2023年11月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

(二)2023年12月7日,公司召开2023年员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》等议案。具体内容详见公司于2023年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年员工持股计划第一次持有人会议决议公告》(公告编号:2023-077)。

(三)2023年12月18日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》,确认公司回购专用证券账户(证券账户号:B885134609)所持有的765,398股公司股票已于2023年12月12日通过非交易过户至2023年员工持股计划账户(证券账户号:B886194995)。具体内容详见公司于2023年12月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2023年员工持股计划首次受让股份完成非交易过户的公告》(公告编号:2023-078)。

(